

博敏电子股份有限公司

为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：深圳市博敏电子有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,500 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 5,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司（含全资或控股子公司）2018 年度拟向银行申请不超过 16 亿元人民币的综合授信额度，公司 2018 年预计对全资子公司深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”）的担保总额不超过人民币 1.2 亿元，公司接受深圳博敏担保总额不超过 1.6 亿元，该事项已经公司第三届董事会第八次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于 2018 年 3 月 28 日刊登的公司《关于 2018 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》（临 2018-012）和 2018 年 4 月 18 日披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（2018-023）。

深圳博敏因日常经营发展需要，向招商银行股份有限公司深圳新洲支行（以下简称“招商银行”）申请授信额度为人民币 1,500 万元，期限一年，由公司为深圳博敏上述授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：深圳市博敏电子有限公司

注册地点：深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区 21 栋、22 栋

注册资本：3300 万元

法定代表人：谢小梅

经营范围：自动化设备软、硬件及应用系统的设计、开发、销售、服务；计算机软硬件的设计、开发、销售、服务；电子电路系统、电子部件及整机的设计、研发、制造、销售、服务；印制电路板的设计、研发、制造、销售、服务；印制电路板元器件的贴装、封装、购销、服务；电子材料的研发、制造、销售、服务；国内商业、物资供销业；投资；经营进出口业务；普通货运；电子部件及整机的制造（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批及禁止项目）。

深圳博敏为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，深圳博敏资产总额为 29,664.21 万元，负债总额为 16,667.54 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元、流动负债总额 16,051.61 万元，净资产为 12,996.67 万元，2017 年实现营业收入 44,409.27 万元，净利润为 277.01 万元。（以上数据经审计）

截至 2018 年 3 月 31 日，深圳博敏资产总额为 28,627.85 万元，负债总额为 15,227.95 万元，其中银行贷款总额 5,000 万元、流动负债总额 14,632.03 万元，资产净额为 13,399.90 万元，2018 年第一季度营业收入 13,818.88 万元，净利润 403.23 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

担保金额：人民币 1,500 万元。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：自与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

保证担保范围：包括但不限于债务本金、利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

四、董事会意见

董事会认为：此次担保是为满足深圳博敏在经营过程中的资金需要，被担保方为公司全资子公司，深圳博敏经营状况稳定，资信情况良好及偿还债务能力较强，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意此次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 211,481.81 万元(除上市公司与合并报表范围内的子公司相互为各自提供的担保外，不存在为其他第三方提供担保的情形)，占公司最近一期经审计净资产的 213.54%；公司对控股子公司提供的担保总额为 130,985.00 万元(含公司与控股子公司之间可互相调配的额度)，占公司最近一期经审计净资产的 132.26%。(未经审计、不含本次担保)

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日